

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/podgrzewacz-bga-led-separator-lcd-plyta-grzewcza-mechanic-heat-air-600w-p-15637.html>

PODGRZEWACZ BGA LED SEPARATOR LCD PŁYTA GRZEWCZA MECHANIC HEAT AIR 600W

Cena brutto	486,56 zł
Cena netto	395,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XUSE0000328
Kod EAN	5903815940934

Opis produktu

USE0000328

PODGRZEWACZ MECHANIC HEAT AIR 600W

- **FORMA UNIWERSALNA**
- **EXTRA FORMA DO IPHONE 16/16 Plus/16 Pro/ 16 Pro MAX**

* Firma Reball Technology Sp. z o.o. jest bezpośrednim oficjalnym dystrybutorem marki **MECHANIC**.

* Każdy oferowany przez nas produkt tej marki jest oryginalny i oznaczony indywidualnym certyfikatem autentyczności który znajdziesz na obudowie, numerem seryjnym oraz certyfikatem CE.



□ Podgrzewacz Mechanic HEAT AIR 600W

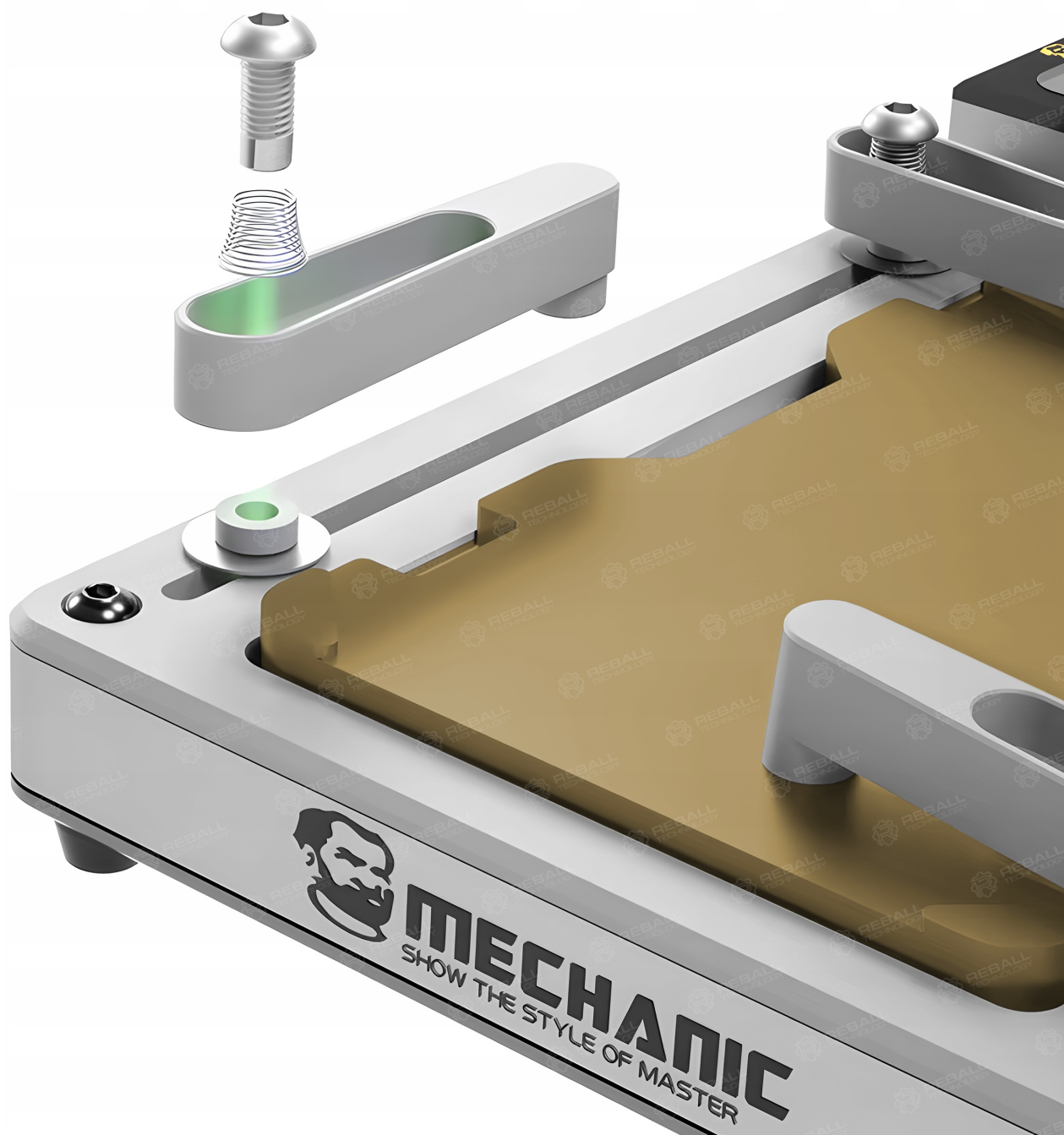
MECHANIC Heat Air to zaawansowana stacja grzewcza do serwisu płyt głównych, zaprojektowana z myślą o bezpiecznym usuwaniu kleju oraz pracach BGA.

Urządzenie wykorzystuje inteligentny system grzania z **zaprogramowanymi profilami temperaturowymi**, co pozwala na precyzyjne i kontrolowane **podgrzewanie bez ryzyka uszkodzenia układów**.

Dzięki zastosowaniu płaskiej formy (**istnieje możliwość wymiany płyty**) możliwe jest stabilne podparcie płyty głównej podczas pracy, co znacząco **zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy przy naprawach iPhone oraz innych urządzeń mobilnych**.

Stacja znajduje zastosowanie w profesjonalnych serwisach GSM oraz pracowniach mikrolutowania.

Ilość: **1szt.**



□ Charakterystyka

- Programowalne profile grzewcze - precyzyjna kontrola temperatury i czasu pracy.
- Stała temperatura - równomierne nagrzewanie płyty bez punktowych przegrzań.
- Funkcja „one-click” - automatyczne rozdzielanie warstw i procesów naprawczych.
- Szybkie nagrzewanie - osiągnięcie temperatury roboczej w około 60 sekund.

- Uniwersalna płaska forma (flat mold) - stabilne podparcie PCB podczas pracy.
- Możliwość wymiany formy - Przystosowanej do specjalistycznych wymagań (brak w zestawie)
- Zastosowanie do: usuwania kleju, reballingu, separacji płyt, lutowania i napraw PCB.



⚙️ Specyfikacja techniczna

- Marka: **MECHANIC**.
- Sterowanie: **inteligentne programy grzania + tryb automatyczny**.

- Czas nagrzewania: **ok. 60 s do temperatury roboczej.**
- Funkcje: **separacja PCB, usuwanie kleju, lutowanie, reflow, reballing.**
- Forma robocza: **uniwersalna płaska (flat mold).**
- Zastosowanie: **płyty główne smartfonów, BGA, CPU, IC.**



□ Zawartość zestawu

- Stacja MECHANIC HEAT AIR 600W - **1 szt.**

- Uniwersalna forma płaska - **1 szt.**
- Forma do serii iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max - **1 szt.**
- Sito do iPhone 16 / 16 Plus - **1 szt.**
- Sito do iPhone 16 Pro / 16 Pro max - **1 szt.**



